



Ref. Certif. No.

**SE-67008**IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Moulded Case Circuit-breaker

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurDelixi Electric Ltd.  
Delixi High-Tech. Industry Park, Liushi Town, Yueqing,  
Zhejiang 325604, CHINAName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Same as above

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine  
Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup>

Same as applicant

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesU<sub>e</sub>= 400V~(3P)  
I<sub>n</sub>= 200, 225, 250, 315, 350, 400A  
I<sub>cu</sub>= 50kA, I<sub>cs</sub>= 30kA, U<sub>i</sub>= 800V~, U<sub>imp</sub>= 6kATrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais  
constructeur

-

Model / Type Ref.  
Ref. De type

HDM1-400L

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

-

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60947-2:2006

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

SH11090553-001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB  
Box 1103  
SE-164 22 Kista, Sweden  
Int +46 8 750 00 00

Signature:

Bo Berglöf

Date: 26 October 2011